



平成 21 年 10 月 28 日

各 位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表者名 執行役社長 大林 秀仁
コード番号 8036 東証 1 部・大証 1 部

会社名 株式会社ルネサス テクノロジ
代表者名 取締役会長 塚本 克博

半導体製造装置事業の再編について

株式会社日立ハイテクノロジーズ(執行役社長：大林 秀仁/以下、日立ハイテク)および株式会社ルネサス テクノロジ(取締役会長：塚本 克博/以下、ルネサス)は、このたび、半導体製造装置事業強化および経営効率の向上を目的として、ルネサスの 100%子会社である株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ(取締役社長：村山 幸男/以下、ルネサス東日本セミコンダクタ)の半導体製造装置事業を日立ハイテクの 100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ(取締役社長：川崎 義直/以下、日立ハイテクインスツルメンツ)に来春を目処として承継させることに基本合意いたしました。

従来は、ルネサス東日本セミコンダクタにて半導体製造装置の開発・製造を行い、グローバル販売の大半を日立ハイテクが担当していました。近年の市場環境変化に柔軟に対応し、事業体制の強化や経営効率の向上とともに、顧客ニーズを反映した新製品開発の迅速化を図っていくため、日立ハイテクとルネサスは、半導体製造装置事業に関する開発から製造、販売、サービスを一体運営とすべきという認識で一致しました。

日立ハイテクは、今回の事業再編によって、市場拡大が期待される半導体後工程装置事業の事業基盤の確立・強化を目指します。具体的には、ルネサス東日本セミコンダクタを吸収分割会社、日立ハイテクインスツルメンツを吸収分割承継会社とする吸収分割を実施し、日立ハイテクインスツルメンツが電子部品実装システムおよび半導体関連製造装置事業にて培った技術力・製品開発力との相乗効果により、一層優れた製品を市場に投入し、ビジネスの拡大を図ります。

一方、ルネサスは、昨年以来の厳しい事業環境下、収益性を確保できる安定的な経営基盤への改善・強化を目的として、生産構造対策や人員リソースの最適化等の施策を実施しています。今回の事業再編は、マイコン事業をコアコンピタンスとした事業強化のためのリソースの有効活用を進める上でも重要な決定です。今後も諸施策の迅速なる完遂により、ルネサスとしての経営基盤の安定化と事業基盤の強化を目指します。

今回の半導体製造装置事業再編の実現に向けて事業精査を行い、この結果に基づき日立ハイテク及び日立ハイテクインスツルメンツ並びにルネサス及びルネサス東日本セミコンダクタとの間で本年 12 月に最終契約を締結する予定です。

尚、今回の半導体製造装置事業再編による、日立ハイテクの平成 22 年 3 月期連結業績予想に与える影響は軽微であります。

<ルネサス東日本セミコンダクタの概要>

会社名 : 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ
代表者 : 取締役社長 村山 幸男
本社所在地 : 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
設立年月日 : 2002 年 10 月 1 日
決算期 : 毎年 3 月末
資本金 : 20 億 6 千万円
株主構成 : ルネサス テクノロジ (100%)
売上高 : 2006 年度 146 億円、2007 年度 180 億円、2008 年度 60 億円 (再編対象事業のみ)
従業員数 : 2,380 名 (再編対象従業員数 : 115 名)
主な事業内容 : 半導体の開発・設計・製造・販売及び半導体製造装置の製造・販売
(再編対象事業 : 半導体製造装置の製造・販売)

<ルネサス テクノロジの概要>

会社名 : 株式会社ルネサス テクノロジ
代表者 : 取締役会長 塚本 克博
取締役社長 赤尾 泰
本社所在地 : 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 日本ビル
設立年月日 : 2003 年 4 月 1 日
決算期 : 毎年 3 月末
資本金 : 1,045 億円 (2009 年 9 月末現在)
株主構成 : 日立製作所 55%、三菱電機 45%
売上高 : 7,027 億円 (連結ベース : 2009 年 3 月期)
従業員数 : 25,000 名 (連結ベース : 2009 年 3 月末現在)
主な事業内容 : マイコン・ロジック・アナログ等のシステム LSI 製品、ディスクリット半導体製品、SRAM 等のメモリ製品の開発、設計、製造、販売、サービスの提供

<日立ハイテクインスツルメンツの概要>

会社名 : 株式会社日立ハイテクインスツルメンツ
代表者 : 取締役社長 川崎 義直
本社所在地 : 埼玉県熊谷市妻沼西一丁目 6 番地
設立年月日 : 1994 年 12 月 1 日
決算期 : 毎年 3 月末
資本金 : 4 億 5 千万円 (2009 年 3 月末現在)
株主構成 : 日立ハイテクノロジーズ 100%
売上高 : 115 億円 (2009 年 3 月期)
従業員数 : 289 名 (2009 年 3 月末現在)
主な事業内容 : 電子部品実装システムおよび半導体関連製造装置の設計・開発・製造

<日立ハイテクノロジーズの概要>

会社名 : 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表者 : 執行役社長 大林 秀仁
本社所在地 : 東京都港区西新橋一丁目24番14号
設立年月日 : 1947年4月12日
決算期 : 毎年3月末
コード番号 : 8036 (東京・大阪)
資本金 : 79億円 (2009年3月末現在)
売上高 : 7,750億円 (連結ベース: 2009年3月期)
従業員数 : 10,508名 (連結ベース: 2009年3月末現在)
主な事業内容 : デバイス製造装置、ライフサイエンス製品の製造・販売・サービス、および情報エレクトロニクス製品、先端産業部材の販売

[報道関係問い合わせ先]

株式会社日立ハイテクノロジーズ 社長室 [担当: 加藤、塩澤]
〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号
電話 (03) 3504-5637 (ダイヤルイン)

株式会社ルネサス テクノロジ 広報・宣伝部 [担当: 小林、上原]
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 日本ビル
電話 (03) 6756-5555 (ダイヤルイン)

以 上